

光部品生産技術部会 講演要旨

開催日：2016年1月28日（木） <2015-4 ②>

テーマ：CO₂レーザによるガラスの異形切断と面取り加工技術の電子製品への応用

講演者：中川考一氏（ファインテック株式会社 代表取締役社長）

フューチャーフォンからスマートフォンへの移り変わりとともに、ガラスは電子製品において液晶パネルのみならず、筐体を保護するカバーガラスにも多用されるようになった。同時にガラスには、筐体として耐え得るだけの高い強度が求められ、強度低下の主原因であるマイクロクラックの発生しない切断加工手法、面取り加工手法が必要とされている。また、液晶パネルやタッチパネルの高精細化と低価格化が急速な勢いで進む中、歩留まりの向上とコスト削減は、業界では社運をかけた必須課題となっている。

ファインテック株式会社では、クリーンで且つ切断後も高い曲げ強度を維持できる、CO₂レーザを用いたガラスの異形切断技術と、面取り加工技術を開発した。既に関係会社であるフォックスコンのカバーガラス工場、液晶パネル工場に生産設備を導入し、強度の高いガラス加工製品を、安価且つ高い歩留まりで生産している。本講演では、フォックスコン工場における当技術を用いた生産を紹介するとともに、この画期的な異形切断加工技術・面取り加工技術の概要に触れた。